

EPEA 中国电子专用设备工业协会 行业简讯

二〇二六年第七期

7 月 23 日发

协会办公室编印

（总第 452 期）

（行业内交流）

内 容 提 要

综合信息

- ☆ 中共中央决定授予赵晋荣同志“全国优秀共产党员”称号
- ☆ 民政部发布《社会团体分支机构、代表机构管理办法》
- ☆ 工信部等三部委发布晶体硅光伏组件能效等级国家标准

行业动态

- ☆ 今年上半年中国大陆 13 类主要半导体设备进口额同比减少 3.9%
- ☆ 2026 年上半年中国大陆 13 类半导体设备出口额同比减少 5.8%
- ☆ 今年上半年中国大陆 SMT 自动贴片机进口额同比增加 8.7%
- ☆ 国产半导体设备零部件距离“成势”仍有相当长的路要走

协会动态

- ☆ 设备制造商 8 月 31 日前填报 2026 年上半年主要经济指标报表
- ☆ 关于召开 2026 年半导体设备年会的通知

知识产权委员会动态

- ☆ 2025 年度国家科技奖励协会会员单位获奖情况
- ☆ 协会二项团体标准公告后实施

- ☆ 政策赋能、价值落地：科创型企业布局中国专利奖的意义
- ☆ 团体标准的真正价值：成为国家标准的进阶基石

会员动态

- ☆ 芯碁微装：正式登陆香港交易所主板
- ☆ 芯碁微装：拿下先进封装领域国产光刻机
- ☆ 托伦斯：在深交所上市
- ☆ 英杰电气：2026 年 1 月 ~ 5 月公司新增订单同比增幅达 96.65%
- ☆ 长川科技：上半年扣非净利润同比增长 139.38%至 167.38%
- ☆ 上海精测：签约 6.51 亿元量检测设备大额订单
- ☆ 捷佳伟创：掩膜喷墨打印设备交付头部晶硅企业
- ☆ 捷佳伟创：TGV 单片清洗设备取得量产订单
- ☆ 富仕三佳：集成电路先进封装模具及设备产业化项目进入建设阶段
- ☆ 盛美上海：ECP 电镀设备实现 2000 腔规模化批量交付
- ☆ 中微公司：当前产能紧张的状态，将是一个相对长久的过程
- ☆ 浙江晶瑞：年 60 万片 8 英寸碳化硅片加速投产

市场动态与预测

- ☆ SEMI 报告：2026 年全球半导体设备销售额预计达 1659 亿美元
- ☆ 今年上半年中国大陆集成电路出口金额增长 150.16%

新会员

- ☆ 苏州博众半导体有限公司

综合信息

中共中央决定授予赵晋荣同志“全国优秀共产党员”称号

7月1日，中共中央发布关于表彰全国优秀共产党员、全国优秀党务工作者和全国先进基层党组织的决定，决定授予北方华创科技集团股份有限公司董事长、执行委员会主席赵晋荣同志“全国优秀共产党员”称号。
(来自：新华网)

(赵晋荣同志现任中国电子专用设备工业协会名誉理事长)

民政部发布《社会团体分支机构、代表机构管理办法》

6月30日，中华人民共和国民政部发布民政部令第85号《社会团体分支机构、代表机构管理办法》并将在2026年8月1日起施行。该办法规定：

(一) 分支机构、代表机构是社会团体的组成部分，不具有法人资格。

(二) 分支机构可以称分会、专业委员会、工作委员会、专家委员会、技术委员会、专项基金管理委员会。分支机构负责人称为主任委员、副主任委员。代表机构负责人称为主任、副主任。

(三) 分支机构、代表机构开展活动时应当使用冠以社会团体名称的规范全称，外文译名应当与中文名称一致。

(来自：民政部)

工信部等三部委发布晶体硅光伏组件能效等级国家标准

7月2日，工业和信息化部联合国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》强制性国标，并从2027年1月1日起执行，低于3级能效组件在国内将禁止生产和销售。标准中晶体硅光伏组件能效等级如下：

产品类别	能效等级		
	1级	2级	3级
	光电转换效率(%)		
TOPCon 电池组件	24.0	23.7	23.2
HJT 电池组件	23.8	23.5	23.2
BC 电池组件	24.2	23.9	23.5

行业动态

今年上半年中国大陆 13 类主要半导体设备进口额同比减少 3.9%

7 月 20 日，海关统计数据在线查询平台公布了 2026 年中国大陆 1 月~6 月 13 类主要半导体设备进口 17672 台，同比增长 42.1%，进口金额 92.46 亿美元，同比减少 3.9%。

上半年，化学气相沉积设备（CVD）和等离子体干法刻蚀机进口额仍然是进口额最大的二类集成电路制造设备，合计进口 56.37 亿美元，占 13 类主要半导体设备总额的 61%。

上半年，引线键合机进口 4.55 亿美元，同比增长 81.3%，增速最快。

2026 年 1~6 月中国大陆 13 类主要半导体设备进口数据表

税则号 8486	设备名称	数量		进口额	
		台	同比增长 %	亿美元	同比增长 %
1010	硅单晶炉	4	-75.0	0.08	-58.5
1020	研磨机	252	20.6	1.87	23.7
1030	切割设备	600	27.4	0.92	-1.0
1040	化学机械抛光机 (CMP)	144	-38.2	2.27	-43.3
2010	氧化扩散炉	574	1.4	8.64	12.9
2021	化学气相沉积设备 (CVD)	832	-4.0	30.72	0.8
2022	物理气相沉积设备 (PVD)	310	17.0	7.38	-1.7
2031	分步重复光刻机	71	-12.3	1.29	-34.3
2041	等离子体干法刻蚀机	705	-6.6	25.65	-14.2
2050	离子注入机	201	-14.1	6.77	-4.8
4021	塑封压机	74	13.8	0.24	-34.3
4022	引线键合机	8191	91.5	4.55	81.3
4031	集成电路工厂专用自动搬运机器人	5714	30.0	2.08	-2.0
总 计		17672	42.1	92.46	-3.9

2026 年 1~6 月化学气相沉积设备发货地情况表（前五名）

	新加坡	日本	韩国	马来西亚	德国	其他
数量(台)	275	214	90	65	49	139
进口额(亿美元)	18.39	3.77	3.09	2.86	1.10	1.51

2026 年 1~6 月等离子体干法刻蚀机发货地情况表（前五名）

	马来西亚	中国台湾	日本	新加坡	美国	其他
数量(台)	105	101	156	53	184	106
进口额(亿美元)	9.12	6.46	4.72	2.19	1.45	1.71

2026 年 1~6 月引线键合机发货地情况表（前四名）

	新加坡	中国	泰国	日本	其他
数量(台)	6366	1172	244	241	168
进口额(亿美元)	3.67	0.54	0.13	0.11	0.10

（数据来自海关统计数据在线查询平台）

2026 年上半年中国大陆 13 类半导体设备出口额同比减少 5.8%

税则号 8542	设备名称	出口量		出口额	
		台	同比增长%	亿美元	同比增长%
1010	利用温度变化处理单晶硅的机器及装置	133	-80.9%	0.11	-92.5%
1020	研磨设备	149	451.9%	0.05	400%
1030	切割设备	230	-44.2%	0.25	-64.8%
1040	化学机械抛光设备(CMP)	19	-5.0%	0.08	-46.7%
2010	氧化、扩散、退火及其它热处理装置	930	161.2%	1.49	217.0%
2021	化学气相沉积装置(CVD)	592	79.4%	2.33	22.0%
2022	物理气相沉积装置(PVD)	23	-28.1%	0.07	-87.3%
2031	分步重复光刻机	11	22.2%	0.19	18.8%
2041	等离子体干法刻蚀机	79	33.9%	0.67	42.6%
2050	离子注入机	41	-65.5%	0.06	-62.5%
4021	塑封机	1834	4.94%	0.30	20.0%
4322	引线键合装置	2283	76.2%	0.83	144.1%
4031	集成电路工厂专用的自动搬运机器人	176	-32.0%	0.06	-76.0%
	总计	6500	75.6%	6.49	-5.8%

（数据来自：海关统计数据在线查询平台）

今年上半年中国大陆 SMT 自动贴片机进口额同比增长 8.7%

7 月 20 日，海关统计数据在线查询平台公布了 2026 年上半年中国大陆 SMT 自动贴片机进口 7312 台，同比减少 2.3%，进口金额 8.32 亿美元，同比增加 8.7%。其中，从日本进口 5267 台，进口金额 5.22 亿美元，占进口总金额的 62.7%。

2026 年 1~6 月中国大陆进口自动贴片机收货地情况表（进口额前五）

收货地	广东省	江苏省	上海市	浙江省	四川省	其他
数量(台)	4,168	1,098	1,260	117	69	501
进口额(亿美元)	3.96	1.84	1.37	0.23	0.17	0.75

（数据来源：海关统计数据在线查询平台）

国产半导体设备零部件距离“成势”仍有相当长的路要走

首先是国产化率仍然偏低。石英件、喷淋头（Shower Head）国产化率超过 10%，真空泵约 5%-10%，而静电卡盘、O 形密封圈、阀门、测量仪器等更低。光刻机相关零部件仍是国产化最薄弱的环节。电气类产品的基础尤其薄弱，与国际先进水平存在明显差距。

其次，验证周期是一道硬门槛。关键零部件的验证周期至少需要 1 年到 1 年半。芯片制造过程对一致性要求极高，零部件供应与设备制造商必须保持高度协同，客户粘性及转换壁垒极高。从测试设备验证到真正的量产设备导入，中间隔着的是无数次工艺跑片、稳定性测试和良率验证。

第三是上游原材料与价格战的挤压。高端金属零部件制造所需的原材料，基本被美国、日本公司垄断，国产零部件厂商在成本端缺乏议价能力。同时，上游原材料涨价，叠加 2025 年零部件企业间的价格战相对激烈，下游产业链压价明显。而半导体零部件细分市场规规模小且碎片化，难以形成规模效应，这对企业的盈利能力构成了持续挑战。

最后，表面处理与特种工艺仍是短板。半导体级表面处理技术要求极高，与普通工业差异巨大。特种焊接、精密传动、超导磁体等高端功能组件，仍是国产零部件需要攻克的硬骨头。

（来自：半导体产业纵横 作者：鹏程）

协会动态

设备制造商 8 月 31 日前填报 2026 年上半年主要经济指标报表

根据协会今年工作的安排，请各会员单位于 8 月 31 日前填报《2026 年上半年电子专用设备产品产销情况分类表》和《2026 年上半年电子专用设备行业主要经济指标表》，发送邮件到协会报表专用邮箱（cepea_vip@126.com）。

- 1、半年报也可登陆协会网站（www.cepea.com），点击报表栏目下载半年报。
- 2、为保护企业的利益，协会只公布行业汇总的数据，不公布每个单位的具体数据。
- 3、行业 2026 年上半年经济运行报告将刊登在协会第九期行业简讯上。

协会联系人：周雨晗 手机：183 4898 0427 电话：010-6886 0519

关于召开 2026 年半导体设备年会的通知

为进一步推动我国半导体装备产业的发展，我协会定于 8 月 31 日~9 月 2 日在无锡市举办“第十四届（2026 年）中国电子专用设备工业协会半导体设备年会”。现将会议有关事项通知如下：

- 一、主办单位：中国电子专用设备工业协会
- 二、会议时间：8 月 31 日~9 月 2 日（8 月 31 日会议报到）
- 三、会议地点：无锡太湖国际博览中心（滨湖区太湖新城清舒道 88 号）
- 四、会议内容
 - 1、2025 年中国半导体设备行业经济运行分析和 2026 年发展展望
 - 2、集成电路晶圆制造装备、先进封装制造装备现状和发展趋势
 - 3、第三代半导体制造装备现状和发展
 - 4、太阳能电池片制造装备最新进展
 - 5、半导体设备核心部件产业发展现状和前景分析

协会联系人：赵鑫宇 手机：15911160248

会务联系人：甘风华 手机：18512101608（微信同号） E-mail: faith@cseac.org.cn

知识产权委员会动态

2025 年度国家科技奖励协会会员单位获奖情况

7 月 8 日，科技部发布 2025 年度国家科技奖励获奖情况，会员单位获奖如下：

2025 年度国家技术发明奖（二等奖）

编号	项目名称	协会会员单位主要完成人
F3-0902-2-01	氮化镓基发光器件关键衬底技术	李东三 (北京北方华创微电子装备有限公司)

2025 年度国家科学技术进步奖（二等奖）

编号	项目名称	主要完成单位（协会会员）
J-216-2-02	新型显示高分辨大面积制造关键技术与装备及其产业化	上海微电子装备(集团)股份有限公司 合肥欣奕华智能机器股份有限公司
J-219-2-04	工业现场高精度视觉测量关键技术与规模化应用	苏州天准科技股份有限公司
J-216-2-05	大型构件能场复合激光制造关键技术与应用	南京 辉锐光电科技有限公司

协会二项团体标准公告后实施

根据《中国电子专用设备工业协会标准管理办法（试行）》相关规定，《集成电路装备用 13.56MHz 射频电源通用技术规范》、《半导体设备前端模块通用技术规范》等二项团体标准通过中国电子专用设备工业协会标准化工作委员会组织的审查，现予以发布，二项标准自 2026 年 6 月 25 日起实施。二项团体标准同时已在全国团体标准信息平台上公示。

序号	标准编号	标准名称	实施日期
1	T/CEPEA 0201-2024	《集成电路装备用 13.56MHz 射频电源通用技术规范》	2026.06.25
2	T/CEPEA 0202-2024	《半导体设备前端模块通用技术规范》	2026.06.25

政策赋能、价值落地：科创型企业布局中国专利奖的意义

中国专利奖是国内顶级国家级知识产权权威荣誉，不只是荣誉表彰，更是科创企业上市审核、资质认定、质押融资、人才申报的官方核心佐证。

1、在科创板上市审核中，上交所重点核查企业专利先进性、产业化成效与技术壁垒。针对科创企业常见的研发投入、专利存量、营收增速等指标短板，中国专利奖可佐证企业核心技术破解行业关键难题、具备规模化落地能力，且获奖专利属于高价值无形资产，能够显著提升企业资本市场估值与认可度。

2、科创资质申报方面，依据国家知识产权局《优势、示范企业知识产权评价指标体系（试行）》，知识产权创造质量、成果运用效益是核心评审指标。中国专利奖作为国家级最高等级知识产权荣誉，可直接拉高企业知识产权创新质量与产业化成效评分，在复核、存续评审中，也可依托专利产业化效益材料，有效规避评分不足、复核不通过风险。

3、在质押融资方面，多地官方已将专利奖专利纳入高价值专利白名单。

4、此外，省市区三级专利奖奖励资金可合规计入研发费用，优化科创评审核心指标，同时作为国家技术发明奖、科技进步奖的重要前置成果，完善企业科创体系。

（来自：中国政府网；北京市、上海市知识产权局；北京市政府网）

团体标准的真正价值：成为国家标准的进阶基石

在行业标准化领域，很多人认为，团体标准的价值，无非是完成编制、上线公示，成为一份彰显企业技术实力、获取行业认可的成果。不少企业耗费人力、物力落地团体标准，却从未真正摸清其核心价值，沦为“为了做标准而做标准”，却未能充分利用。

团体标准不是一份简单的技术性文件，更是我国标准化体系中承上启下的关键枢纽，是企业深耕行业、抢占技术话语权、冲刺国家级标准的核心底牌。读懂团体标准的底层运行逻辑，才能真正发挥其产业价值，实现从行业跟随者到行业引领者的蜕变。

具备价值的团体标准，须满足多重核心要求：（1）技术内容具备原创性与实用性，精准解决行业实际痛点；（2）与上位国标、行标衔接顺畅，无重复、无冲突；（3）条文表述规范严谨，可落地、可执行；编制流程合规完善，充分吸纳行业共识；（4）公示后能够真正应用于生产、采购、服务等产业场景。

（来自：帮筑网）

会员动态

芯碁微装：正式登陆香港交易所主板

6月26日，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称：“芯碁微装”）正式在香港交易所主板挂牌上市（股票代码:09630.HK）。

程卓董事长表示，公司将始终坚持技术立企、创新驱动，持续加码高端直写光刻装备的产能建设，深耕纳米级光刻技术、先进封装光刻解决方案、泛半导体直写成像装备的技术迭代与产业落地，以更领先的技术壁垒、更优质的产品服务、更稳健的经营业绩与更可持续的发展态势，回馈客户、回报股东、赋能产业。

（来自：芯碁微装）

芯碁微装：拿下先进封装领域国产光刻机

7月3日，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称：“芯碁微装”）自主研发的国内首台510×515mm板级封装直写光刻设备PLP 2000完成技术定型，目前已成功拿下先进封装领域核心客户订单，实现大板级先进封装光刻设备国产零的突破。

PLP 2000针对高阶IC载板、超大板先进封装工艺打造，510×515mm超大板面加工规格适配当前AI算力芯片封装主流产线需求。

此前同类大板级直写光刻设备长期由海外厂商垄断，本次新品量产落地，补齐国内先进封装设备关键短板，大幅降低本土封测企业设备采购与维护成本。

当前AI服务器、HBM先进封装行业持续扩产，高阶载板、超大板封装产线投资需求集中释放，直写光刻是封装制程核心刚需设备。

芯碁微装此前披露全产线满产、订单饱满，本次PLP 2000获客户采购订单，进一步扩充高端设备产品矩阵，巩固公司在封装光刻设备赛道龙头地位。依托一、二期厂区协同产能，公司可快速完成PLP 2000批量交付。该设备可覆盖存储、算力芯片配套载板全流程光刻工序，适配国内头部封测厂、IC载板厂商扩产规划，加速先进封装设备国产替代进程。

（来自：半导体工艺与设备）

托伦斯：在深交所上市

7月10日，托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称：“托伦斯”或“公司”）在深交所上市（股票代码：301583）。托伦斯主要从事半导体及激光设备精密零部件的研发、生产和销售。2025年度，公司实现营业收入7.20亿元，净利润9,817.56万元。

（来自：东方财富网）

英杰电气：2026年1月~5月公司新增订单同比增幅达96.65%

证券日报网讯，7月13日四川英杰电气股份有限公司（简称：“英杰电气”）在互动平台回答投资者提问时表示，2026年1月~5月公司新增订单同比增幅达96.65%，受订单大幅增长带动，产能利用率快速回升。

（来自：英杰电气）

长川科技：上半年扣非净利润同比增长139.38%至167.38%

6月23日，杭州长川科技股份有限公司（简称：“长川科技”）发布2026年半年度业绩预告，扣除非经常性损益后的净利润为8.55~9.55亿元，同比增长139.38%至167.38%。

业绩变动原因说明：报告期内，前期研发投入的成果持续显现，叠加高端下游市场需求显著释放，公司数字测试机等多产品线销售业绩大幅度增长，规模效应显现，销售收入规模大幅度增长，利润随之迅速增长。

（来自：长川科技）

上海精测：签约6.51亿元量检测设备大额订单

近日，上海精测半导体技术有限公司（简称：“上海精测”）接连签约，合计拿下6.51亿元设备订单，供货膜厚、OCD、电子束明场缺陷半导体前道量测设备，应用场景主要为先进存储等相关领域。量测设备是晶圆制造刚需装备，此前海外产品长期垄断市场。这笔大单落地，代表本土设备性能通过头部客户验证，产业化从研发阶段迈入批量供货。

（来自：精测电子）

捷佳伟创：掩膜喷墨打印设备交付头部晶硅企业

近日，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称：“捷佳伟创”）自主研发的专用高精度掩膜喷墨打印设备正式交付国内头部晶硅光伏企业。该设备专为 BC 电池背面 Poly 层图形化工艺定制，替代传统激光开槽、干膜光刻方案，实现 BC 电池钝化层精细化图形化低成本量产。

该设备专为 TBC/IBC/HBC 各类 BC 电池背面 Poly 钝化层图形化打造，采用低温湿法掩膜打印路线，完整替代行业主流激光开槽、传统干膜光刻两套方案，可直接对接捷佳伟创现有槽式湿法产线，适配存量 TOPCon 产线升级 BC 改造，无需大规模拆改原有工段。

（来自：第一财经）

捷佳伟创：TGV 单片清洗设备取得量产订单

近日，捷佳伟创再传重磅突破，公司自研 TGV 单片清洗装备成功取得国内 TGV 头部企业量产订单，首次将成熟半导体单片清洗技术落地超薄玻璃基板赛道，补齐国产 TGV 精密清洗关键装备领域短板，助力先进封装设备国产化提速。

该设备采用单片式清洗架构，搭配机能水工艺，可同步清洁基板表面与边缘，深度清除盲孔、通孔内颗粒与有机物，对 1 μ m 以上颗粒的去除率超 99%。同时，设备搭载伯努利非接触吸盘，有效降低基板碎片率至 10ppm 以下，可适配 80 μ m 超薄玻璃加工；上下料分区采用百级洁净管控，杜绝基板二次污染。

（来自：晶盛机电）

富仕三佳：集成电路先进封装模具及设备产业化项目进入建设阶段

铜陵富仕三佳机器有限公司（简称“富仕三佳”）近日以 2100 万元竞价拍得位于铜陵市黄山大道 999 号（B 地块）工业用地，标志着该项目即将进入实质建设阶段。

据了解，该项目达产后预计年均税收贡献不低于 3000 万元，计划形成年产晶圆级封装系统 10 台、粉末先进封装系统 20 台、先进封装模具 300 套，同时配套生产传统封装模具 600 套，实现高端先进产品与传统产品协同发展。

（来自：上海证券报·中国证券网）

盛美上海：ECP 电镀设备实现 2000 腔规模化批量交付

7 月 2 日，盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称：“盛美上海”或“公司”)宣布，公司迎来了重要里程碑—盛美上海 ECP 电镀设备 2000 腔正式出机、批量交付。

自 2017 年首台 Ultra ECP ap 设备进入先进封装客户验证、2019 年成功切入前道 IC 制造，盛美上海电镀业务稳步提速，先后在 2022 年突破 500 腔、2025 年突破 1500 腔交付规模，并于 2026 年 6 月正式迈入 2000 腔量产交付新阶段。

盛美上海拥有全覆盖的集成电路电镀产品矩阵，覆盖前道铜互连、先进封装、化合物半导体、面板级先进封装四大应用场景，适配 6/8/12 英寸晶圆及大尺寸面板全制程需求。公司电镀业务市场，2025 年全球市占率位列第二，国内 12 英寸铜互连电镀设备市占率稳居第一。

(来自：盛美上海)

中微公司：当前产能紧张的状态，将是一个相对长久的过程

7 月 2 日，中微半导体设备(上海)股份有限公司（以下简称：“中微公司”或“公司”）在接受调研者提问时表示，公司出现供应紧张的主要原因是公司产能增长的速度没有赶上下游客户对公司产品需求增长速度。当前公司产能、出货量是增长的，未交货订单也是增长的。对于当前产能紧张的状态，公司判断这种状态将是一个相对长久的过程。

(来自：证券日报网)

浙江晶瑞：年 60 万片 8 英寸碳化硅片加速投产

浙江晶瑞电子材料有限公司(简称：浙江晶瑞)始终专注于 SiC 等化合物半导体材料的研发、生产与销售，具备从晶体生长到切磨抛、检测的全链条能力，核心设备自主可控。

本次扩产项目实现无人化自动运行和数字化管控，保证车规级 SiC 晶片的质量稳定可靠性和全线可追溯性，建设成为行业领先的全自动智能工厂。战略布局方面，同步建设的马来西亚工厂预计在 2026 年底通线投产，为全球客户提供多元化的供应保障。

(来自：晶盛机电)

市场动态与预测

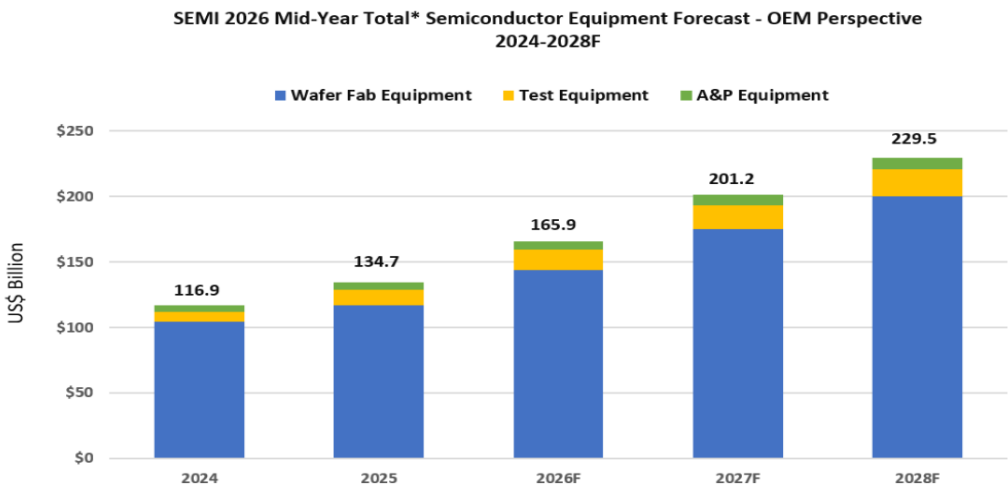
SEMI 报告：2026 年全球半导体设备销售额预计达 1659 亿美元

美国加州时间 2026 年 7 月 14 日，SEMI 在发布《年中总半导体设备市场预测报告》(Mid-Year Total Semiconductor Equipment Forecast - OEM Perspective) 中指出，预测 2026 年全球半导体制造设备 (OEM) 总销售额将创下 1659 亿美元的历史新高，同比增长 23.2%。增长势头预计将持续至 2028 年，总设备销售额有望达到创纪录的 2295 亿美元，实现连续五年增长，AI 驱动的需求正在重塑半导体制造投资格局。

半导体设备销售额（按细分市场划分）

晶圆厂设备 (WFE) 领域（包括晶圆加工、晶圆厂设施和掩膜/光罩设备）预计 2026 年将增长 23.1% 至 1439 亿美元。这反映了先进存储（尤其是 HBM 相关 DRAM 技术）和前沿逻辑应用投资的增强。WFE 细分销售额预计 2027 年再增长 21.8%，2028 年增长 14.1%，突破 2000 亿美元大关，因为制造商正在加速产能扩张和技术迁移以满足 AI 相关工作负载需求。

AI 相关半导体需求也在推动后端设备领域市场扩张。半导体测试设备销售额预计 2026 年将增长 31% 至 153 亿美元。封装设备销售额预计 2026 年将增长 9.6% 至 67 亿美元，与此前预测基本一致。增长预计将持续至 2028 年，测试设备将达到 208 亿美元，封装设备将达到 86 亿美元，这得益于器件复杂度提升、先进异构封装采用率提高，以及 AI 和 HBM 器件对性能和可靠性更严格的要求。

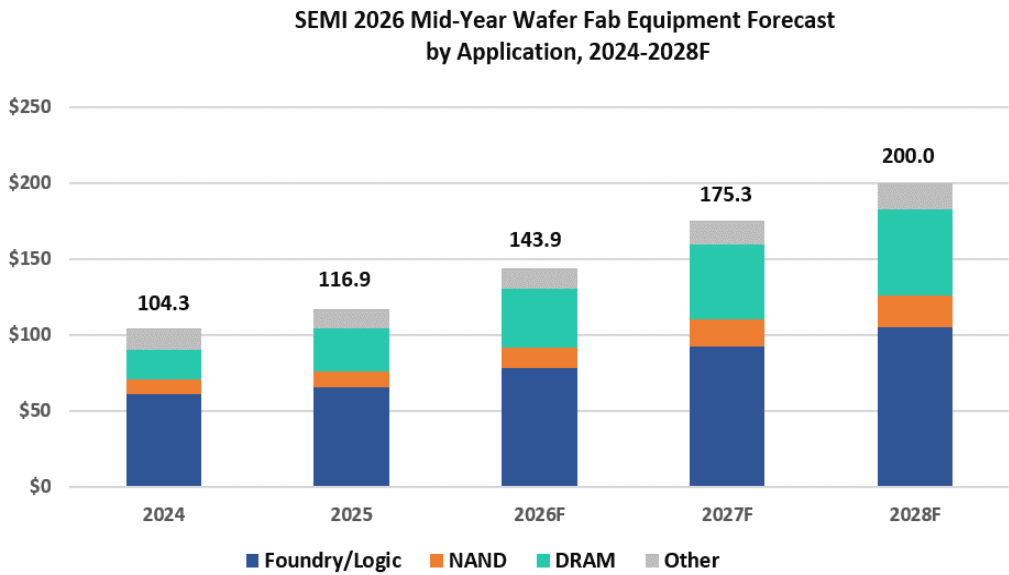


Source: SEMI Equipment Market Data Subscription (EMDS), July 2026

*Total equipment includes new wafer fab, test, assembly, and packaging, but does not include wafer manufacturing equipment.

半导体设备销售额（按细分市场划分）

用于 Foundry 和 Logic 应用的 WFE 销售额 2026 年预计同比增长 18.9%至 780 亿美元，这得益于 AI 加速器、高性能计算和高端移动处理器的前沿节点产能建设。该细分市场预计 2027 年增长 18.1%，2028 年增长 13.6%，达到 1047 亿美元，因为行业正迈向 2nm 全环绕栅级（GAA）节点的大规模量产。



Source: SEMI Equipment Market Data Subscription (EMDS), July 2026

存储相关设备支出受 HBM 需求、先进 DRAM 节点迁移和 NAND 技术转型推动，预计将在 2028 年前显著扩张。DRAM 设备销售额预计 2026 年增长 39.0%至 388 亿美元，随后 2027 年增长 27.4%，2028 年增长 15.0%，达到 569 亿美元。NAND 设备销售额预计 2026 年增长 30.7%至 139 亿美元，2027 年再增长 31.1%，2028 年增长 14.5%，达到 208 亿美元，这得益于 3D NAND 层数迁移和更高密度架构投资。

半导体设备销售额（按地区划分）

中国大陆、中国台湾和韩国预计将在 2028 年前继续保持设备支出前三名的地位。中国大陆预计在预测期内维持领先地位，但 2026 年增速预计将放缓，因近年来投资水平已处于高位。中国台湾地区设备支出受 AI 和高性能计算前沿产能建设支撑；韩国设备支出则由先进存储技术（包括 HBM）驱动。

（来自：SEMI China）

2026 年上半年中国大陆集成电路出口额同比增长 150.16%

在 AI 市场的推动下，对 AI 相关集成电路的需求爆发式增长，价格也不断上涨，带动了中国集成电路出口的大幅增长。

今年 1~6 月，集成电路出口 1345.90 亿个，同比增长 9.03%，出口金额 1465.64 亿美元，同比增长 150.16%。其中用作存储器的集成电路（税则号 85423290）出口 163.16 亿个，同比增长 13.89%，出口金额 1138.13 亿美元，同比增长 221.71%，占集成电路总出口额的 77.65%。

（数据来自海关统计数据在线查询平台）

新会员

苏州博众半导体有限公司

会员证号：10026

法定代表人：程银民 总经理：于 军

该公司是一家私有企业，公司专业从事集成电路封测设备的研制与销售。主要产品有共晶机、固晶机、AOI 检测机等。该公司 2025 年完成销售额 1 亿元。公司现有职工 210 人，其中工程技术人员 120 人。

地址：江苏省苏州市吴江经济开发区湖心西路 666 号

邮编：215200

<https://www.bozemi.com> 手机：180 2146 2023 E-mail: shuai.wu@bozhon.com

协会通信地址：北京市复兴路 49 号 C 座 001 邮编：100036

电话：(010) 68860519

传真：(010) 68865302

<https://www.cepea.com>

E-mail: bgs@cepea.com